2024-2029年中国半导体材料行业市场需求前景与投资规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：半导体材料行业概念界定及发展环境剖析
1.1 半导体材料的概念界定及统计口径说明
1.1.1 半导体材料概念界定
1.1.2 半导体材料的分类
（1）前端制造材料
（2）后端封装材料
1.1.3 行业所属的国民经济分类
1.1.4 本报告的数据来源及统计标准说明
1.2 半导体材料行业政策环境分析
1.2.1 行业监管体系及机构
1.2.2 行业规范标准
1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读（指导类/支持类/限制类）
（1）行业发展相关政策/规划汇总
1.2.4 行业重点规划/政策解读
（1）国家层面
1）“十四五”规划纲要
2）《国家集成电路产业发展推进纲要》
3）《“十四五”原材料工业发展规划》
4）《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
（2）地方层面
1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析
1.3 半导体材料行业经济环境分析
1.3.1 宏观经济现状
（1）中国GDP及增长情况
（2）中国三次产业结构
（3）中国工业经济增长情况
（4）中国固定资产投资情况
1.3.2 经济转型升级发展分析（智能制造）
1.3.3 宏观经济展望
（1）国际机构对中国GDP增速预测
（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测
1.3.4 经济环境对行业发展的影响分析
1.4 半导体材料行业投资环境分析
1.4.1 国家集成电路产业投资基金
（1）大基金一期
（2）大基金二期
1.4.2 半导体材料行业投资、兼并与重组分析
（1）半导体材料行业兼并与重组发展现状分析
1）半导体材料行业兼并与重组事件汇总
2）半导体材料行业兼并与重组动因分析
3）半导体材料行业兼并与重组趋势预判
（2）半导体材料行业投融资事件分析
1）半导体材料行业资金来源
2）半导体材料行业投融资主体
3）半导体材料行业投融资事件汇总
4）半导体材料行业投融资信息汇总
1.4.3 投资环境对行业发展的影响分析
1.5 半导体材料行业技术环境分析
1.5.1 半导体行业技术迭代
1.5.2 美国对中国半导体行业的相关制裁事件
1.5.3 半导体材料行业技术发展趋势

1.5.4 技术环境对行业发展的影响分析
第2章：全球及中国半导体行业发展及半导体材料所处位置
2.1 全球半导体产业迁移历程分析
2.1.1 全球半导体产业迁移路径总览
2.1.2 阶段一：从美国向日本迁移
2.1.3 阶段二：向韩国、中国台湾迁移
2.1.4 阶段三：向中国大陆地区转移
2.1.5 全球半导体产业发展总结分析
2.2 全球半导体行业发展现状分析
2.2.1 全球半导体行业市场规模
2.2.2 全球半导体行业需求竞争格局
2.2.3 全球半导体行业产品竞争格局
2.2.4 全球半导体行业区域竞争格局
2.3 中国半导体行业发展现状分析
2.3.1 中国半导体行业市场规模
2.3.2 中国半导体行业结构竞争格局
（1）半导体行业细分市场结构
（2）半导体设计环节规模
（3）半导体制造环节规模
（4）半导体封装测试环节规模
2.3.3 中国半导体行业区域竞争格局
2.4 半导体材料与半导体行业的关联
2.4.1 半导体材料在半导体产业链中的位置
2.4.2 半导体材料对半导体行业发展的影响分析
2.5 全球及中国半导体行业发展前景及趋势分析
2.5.1 半导体行业发展前景分析
（1）全球半导体行业发展前景分析
（2）中国半导体行业发展前景分析
2.5.2 半导体行业发展趋势分析
（1）全球半导体行业发展趋势分析
（2）中国半导体行业发展趋势分析
第3章：全球半导体材料行业发展现状及前景分析
3.1 全球半导体材料行业发展现状分析
3.1.1 全球半导体材料行业发展历程
3.1.2 全球半导体材料行业市场规模
3.1.3 全球半导体材料行业竞争格局
（1）区域竞争格局
（2）产品竞争格局
1）晶圆制造材料
2）封装材料
（3）企业/品牌竞争格局
3.2 全球主要国家/地区半导体材料行业发展现状分析
3.2.1 中国台湾地区半导体材料行业发展分析
（1）半导体材料行业发展特点
（2）半导体材料行业市场规模
（3）半导体材料行业在全球的地位
3.2.2 韩国半导体材料行业发展分析
（1）半导体材料行业发展特点
（2）半导体材料行业市场规模
（3）半导体材料行业在全球的地位
3.2.3 日本半导体材料行业发展分析
（1）半导体材料行业发展特点
（2）半导体材料行业市场规模
（3）半导体材料行业在全球的地位
3.2.4 北美半导体材料行业发展分析
（1）半导体材料行业发展特点
（2）半导体材料行业市场规模
（3）半导体材料行业在全球的地位
3.3 全球半导体材料代表企业案例分析

3.3.1 日本揖斐电株式会社（IBIDEN）
（1）企业基本情况
（2）企业经营情况
（3）企业半导体材料业务布局
（4）企业在华投资布局情况
3.3.2 日本信越化学工业株式会社
（1）企业基本情况
（2）企业经营情况
（3）企业半导体材料业务布局
（4）企业在华投资布局情况
3.3.3 日本株式会社SUMCO
（1）企业基本情况
（2）企业经营情况
（3）企业半导体材料业务布局
（4）企业在华投资布局情况
3.3.4 空气化工产品有限公司
（1）企业基本情况
（2）企业经营情况
（3）企业半导体材料业务布局
（4）企业在华投资布局情况
3.3.5 林德集团
（1）企业基本情况
（2）企业经营情况
（3）企业半导体材料业务布局
（4）企业在华投资布局情况
3.4 全球半导体材料行业发展前景及趋势
3.4.1 全球半导体材料行业发展前景分析
3.4.2 全球半导体材料行业发展趋势分析
第4章：中国半导体材料行业发展现状分析
4.1 中国半导体材料行业发展概述
4.1.1 中国半导体材料行业发展历程分析
4.1.2 中国半导体材料行业市场规模分析
4.1.3 中国半导体材料行业在全球的地位分析
4.1.4 中国半导体材料行业企业竞争格局
4.2 中国半导体材料行业进出口分析
4.2.1 中国半导体材料行业进出口市场分析
4.2.2 中国半导体材料行业进口分析
（1）行业进口贸易规模
（2）行业进口产品结构
4.2.3 中国半导体材料行业出口分析
（1）行业出口贸易规模
（2）行业出口产品结构
4.3 中国半导体材料行业波特五力模型分析
4.3.1 现有竞争者之间的竞争
4.3.2 供应商议价能力分析
4.3.3 消费者议价能力分析
4.3.4 行业潜在进入者分析
4.3.5 替代品风险分析
4.3.6 竞争情况总结
4.4 中国半导体材料行业发展痛点分析
4.4.1 半导体材料核心需求不足
4.4.2 半导体材料对外依存度大
4.4.3 半导体材料上下游联动不足
第5章：中国半导体材料行业细分市场分析
5.1 中国半导体材料应用及细分市场构成分析
5.1.1 半导体材料在半导体制造中的应用
5.1.2 半导体材料细分市场现状
（1）中国半导体材料细分市场结构
（2）中国晶圆制造材料细分产品规模

（3）中国封装材料细分产品规模
5.2 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析
5.2.1 中国半导体硅片发展现状及趋势分析
（1）半导体硅片工艺概述
（2）半导体硅片技术发展分析
（3）半导体硅片发展现状分析
1）半导体硅片发展历程
2）半导体硅片供给情况
3）中国半导体硅片市场规模
（4）半导体硅片竞争格局
（5）半导体硅片国产化现状
（6）半导体硅片发展趋势分析
5.2.2 中国电子特气发展现状及趋势分析
（1）电子特气工艺概述
（2）电子特气技术发展分析
（3）电子特气发展现状分析
1）电子特气发展历程
2）电子特气产能
3）电子特气市场规模
（4）电子特气竞争格局
（5）电子特气国产化现状
1）政策扶持
2）已实现国产化产品
3）产品国产化率
（6）电子特气发展趋势分析
5.2.3 中国光掩膜版发展现状及趋势分析
（1）光掩膜版工艺概述
（2）光掩膜版技术发展分析
（3）光掩膜版发展现状分析
1）光掩膜版产能分布
2）光掩膜版市场规模
（4）光掩膜版竞争格局
（5）光掩膜版国产化现状
（6）光掩膜版发展趋势分析
5.2.4 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析
（1）光刻胶及配套材料工艺概述
（2）光刻胶及配套材料技术发展分析
（3）光刻胶及配套材料发展现状分析
1）光刻胶及配套材料发展历程
2）光刻胶及配套材料市场规模
（4）光刻胶及配套材料竞争格局
（5）光刻胶及配套材料国产化现状
（6）光刻胶及配套材料发展趋势分析
5.2.5 中国抛光材料发展现状及趋势分析
（1）抛光材料工艺概述
（2）抛光材料技术发展分析
（3）抛光材料发展现状分析
1）抛光材料发展历程
2）抛光材料市场规模
（4）抛光材料竞争格局
（5）抛光材料国产化现状
（6）抛光材料发展趋势分析
5.2.6 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析
（1）湿电子化学品工艺概述
（2）湿电子化学品技术发展分析
（3）湿电子化学品发展现状分析
1）湿电子化学品发展历程
2）湿电子化学品市场规模
（4）湿电子化学品竞争格局

（5）湿电子化学品国产化现状
（6）湿电子化学品发展趋势分析
5.2.7 中国靶材发展现状及趋势分析
（1）靶材工艺概述
（2）靶材技术发展分析
（3）靶材发展现状分析
1）靶材发展历程
2）靶材市场规模
（4）靶材竞争格局
（5）靶材国产化现状
（6）靶材发展趋势分析
5.3 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析
5.3.1 中国封装基板发展现状及趋势分析
（1）封装基板工艺概述
（2）封装基板技术发展分析
（3）封装基板发展现状分析
1）封装基板发展历程
2）封装基板市场规模
（4）封装基板竞争格局
（5）封装基板国产化现状
（6）封装基板发展趋势分析
5.3.2 中国引线框架发展现状及趋势分析
（1）引线框架工艺概述
（2）引线框架技术发展分析
（3）引线框架发展现状分析
1）引线框架发展历程
2）引线框架市场规模
（4）引线框架竞争格局
（5）引线框架国产化现状
（6）引线框架发展趋势分析
5.3.3 中国键合线发展现状及趋势分析
（1）键合线工艺概述
（2）键合线技术发展分析
（3）键合线发展现状分析
1）键合线需求现状
2）键合线市场规模
（4）键合线竞争格局
（5）键合线国产化现状
（6）键合线发展趋势分析
5.3.4 中国塑封料发展现状及趋势分析
（1）塑封料工艺概述
（2）塑封料技术发展分析
（3）塑封料市场规模分析
（4）塑封料竞争格局
（5）塑封料国产化现状
（6）塑封料发展趋势分析
5.3.5 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析
（1）陶瓷封装材料工艺概述
（2）陶瓷封装材料技术发展分析
（3）陶瓷封装材料市场规模分析
（4）陶瓷封装材料竞争格局
（5）陶瓷封装材料国产化现状
（6）陶瓷封装材料发展趋势分析
第6章：中国半导体材料行业领先企业生产经营分析
6.1 半导体材料行业代表企业概况
6.1.1 代表企业概况
6.1.2 代表企业半导体材料产品布局
6.1.3 代表企业营收、毛利率等对比
6.2 半导体材料行业代表性企业案例分析

6.2.1 天津中环半导体股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.2 上海硅产业集团股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.3 浙江金瑞泓科技股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.4 有研新材料股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构

2）企业销售网络
（4）企业半导体材料业务布局
（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.8 安集微电子科技（上海）股份有限公司
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业经营状况分析
（3）企业业务结构及销售网络
1）企业业务结构
2）企业销售网络
（4）企业半导体材料战略布局及最新发展动态
（5）企业发展半导体材料业务的优劣势分析
6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
（4）企业销售渠道与网络分析
（5）企业经营状况优劣势分析
6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
（4）公司气体供应模式分析
（5）企业销售渠道与网络分析
（6）企业经营状况优劣势分析
6.2.11 广东华特气体股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
（4）企业气体供应模式分析
1）气瓶模式
2）槽车模式
（5）企业销售渠道与网络分析
（6）企业经营状况优劣势分析
6.2.12 广东光华科技股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
（4）企业销售渠道与网络分析
（5）企业发展优劣势分析
6.2.13 江阴江化微电子材料股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
1）超净高纯试剂业务
2）光刻胶配套试剂业务
（4）企业销售渠道与网络分析
（5）企业发展优劣势分析
6.2.14 江苏南大光电材料股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
1）MO源产品业务
2）半导体前驱体产品业务
3）电子特气产品业务
4）ArF光刻胶
（4）企业销售渠道与网络分析
（5）企业发展优劣势分析
6.2.15 宁波江丰电子材料股份有限公司

（1）企业发展简况分析
（2）企业经营状况分析
（3）企业产品结构分析
（4）企业销售渠道与网络分析
（5）企业发展优劣势分析
6.2.16 台湾欣兴电子股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业产品结构分析
（4）企业在大陆投资布局情况
第7章：中国半导体材料行业市场前瞻及投资策略建议
7.1 中国半导体材料行业市场前瞻
7.1.1 半导体材料行业生命周期判断
7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估
7.1.3 半导体材料行业前景预测
7.2 中国半导体材料行业投资特性
7.2.1 行业进入壁垒分析
7.2.2 行业退出壁垒分析
7.2.3 行业投资风险预警
7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会
7.3.1 行业投资价值评估
7.3.2 行业投资机会分析
7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议
7.4.1 行业投资策略与建议
7.4.2 行业可持续发展建议

图表目录

图表1：半导体前端制造材料分类及主要用途
图表2：半导体后端封装材料分类及主要用途
图表3：半导体材料行业所属的国民经济分类
图表4：报告的研究方法及数据来源说明
图表5：中国半导体材料行业监管体制
图表6：截至2023年中国半导体材料标准汇总
图表7：截至2023年半导体材料行业发展主要政策汇总
图表8：《国家集成电路产业发展推进纲要》政策解读与规划
图表9：碳基材料纳入《“十四五”原材料工业发展规划》意义
图表10：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》政策解读
图表11：“十四五”期间中国31省市半导体行业政策规划汇总及解读
图表12：政策环境对中国半导体行业发展的影响总结
图表13：2010-2022年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）
图表14：2010-2022年中国三次产业结构（单位：%）
图表15：2010-2022年中国全部工业增加值及增速（单位：万亿元，%）
图表16：2010-2022年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）
图表17：截至2023年全国智能制造能力成熟度自诊断企业分布（单位：家）
图表18：截至2023年全国智能制造能力成熟度水平（单位：%，家）
图表19：部分国际机构对2023年中国GDP增速的预测（单位：%）
图表20：2015-2022年中国GDP与半导体材料行业营收规模相关性
图表21：中国大基金一期半导体材料投资标的（单位：亿元，%）
图表22：中国大基金二期投资布局规划
图表23：截至2022年中国大基金二期投资领域分布（单位：%）
图表24：截至2022年中国大基金二期投资项目汇总（单位：亿元，%）
图表25：2017-2023年中国半导体材料行业并购交易案汇总（单位：%）
图表26：中国半导体行业兼并与重组类型和动因分析
图表27：半导体材料行业资金来源分析
图表28：中国半导体材料行业投融资主体分析

图表29：2022-2023年中国半导体材料行业投融资事件汇总
图表30：2013-2023年中国半导体材料行业投融资事件情况分析（单位：件，亿元）
图表31：截至2023年中国半导体材料行业投融资轮次分布（单位：%）
图表32：半导体行业技术迭代历程
图表33：截至2023年美国对中国半导体行业制裁发展历程
图表34：截至2023年美国对中国半导体行业的相关制裁事件汇总
图表35：国内半导体晶圆制造材料产业发展趋势
图表36：国内半导体封装材料产品发展趋势
图表37：全球半导体产业迁移路径图
图表38：全球半导体产业迁移结构
图表39：全球半导体产业发展格局分析
图表40：2011-2022年全球半导体产业市场规模及预测（单位：亿美元，%）
图表41：2020-2022年全球推动未来一年内半导体公司收入增长的应用领域
图表42：2015-2022年全球半导体行业细分市场结构（单位：亿美元）
图表43：2021-2022年全球半导体行业细分市场份额（单位：%）
图表44：2021-2022年全球半导体行业地区分布（单位：%）
图表45：2015-2022年中国集成电路行业销售额（单位：亿元，%）
图表46：2011-2022年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况（单位：%）
图表47：2015-2022年中国集成电路设计业销售额和增长情况（单位：亿元，%）
图表48：2015-2022年中国集成电路制造业销售额和增长情况（单位：亿元，%）
图表49：2015-2022年中国集成电路封装测试业销售额及增长情况（单位：亿元，%）
图表50：2011-2022年中国集成电路产量和增速情况（单位：亿块，%）
图表51：2022年1-12月中国集成电路累计产量TOP10省市（单位：%）
图表52：半导体产业链
图表53：2011-2022年全球半导体材料市场规模占半导体市场规模比重情况（单位：%）
图表54：2023-2028年全球半导体行业市场规模预测（单位：亿美元）
图表55：2023-2028年中国集成电路行业销售额预测（单位：亿元）
图表56：全球半导体行业发展趋势分析
图表57：中国半导体行业发展趋势分析
图表58：全球半导体材料行业发展历程
图表59：2011-2022年全球半导体材料市场规模及其增长情况（单位：亿美元，%）
图表60：2020-2021年全球主要国家和地区半导体材料市场规模变化情况（单位：%）
图表61：2011-2022年全球半导体材料结构竞争格局（单位：亿美元）
图表62：2011-2022年全球半导体材料结构情况（单位：%）
图表63：2021年全球半导体晶圆制造材料市场结构（单位：%）
图表64：2021年全球半导体封装材料市场结构（单位：%）
图表65：全球半导体材料行业企业竞争格局（按主要领域分）
图表66：中国台湾地区主要半导体产业集群
图表67：2012-2022年中国台湾地区半导体材料市场规模情况（单位：亿美元）
图表68：2012-2021年中国台湾地区半导体材料市场规模占全球比重变化（单位：%）
图表69：韩国主要半导体产业集群
图表70：2012-2022年韩国半导体材料市场规模情况（单位：亿美元）
图表71：2012-2021年韩国半导体材料市场规模占全球比重变化（单位：%）
图表72：日本主要半导体产业集群
图表73：2012-2022年日本半导体材料市场规模情况（单位：亿美元）
图表74：2012-2021年日本半导体材料市场规模占全球比重变化（单位：%）
图表75：美国《2022年芯片与科学法案》拨款及用途
图表76：2012-2022年北美地区半导体材料市场规模情况（单位：亿美元）
图表77：2012-2021年北美地区半导体材料市场规模占全球比重变化（单位：%）
图表78：2017-2021财年日本揖斐电株式会社经营情况（单位：亿日元）
图表79：日本揖斐电株式会社半导体材料业务布局
图表80：2017-2022财年信越化学工业株式会社经营情况（单位：亿日元）
图表81：信越化学工业株式会社半导体材料业务布局
图表82：日本信越化学工业株式会社在华投资布局情况
图表83：SUMCO公司历史进程
图表84：2017-2022年株式会社SUMCO经营情况（单位：亿日元）
图表85：株式会社SUMCO半导体材料业务布局
图表86：SUMCO公司硅片规格（单位：毫米）
图表87：SUMCO公司在华布局情况

图表88：2017-2022财年空气化工产品有限公司经营情况（单位：亿美元）
图表89：空气化工产品有限公司半导体材料业务专利技术
图表90：2018-2022年林德集团（Linde AG）营收（单位：亿美元）
图表91：林德集团半导体材料业务布局
图表92：2023-2028年全球半导体材料行业市场规模预测（单位：亿美元）
图表93：中国半导体材料行业发展历程
图表94：2012-2022年中国半导体材料市场规模（单位：亿美元）
图表95：2012-2021年中国半导体材料市场规模占全球比重变化（单位：%）
图表96：2022年中国大陆主要半导体材料企业竞争情况（单位：亿元，%）
图表97：中国半导体材料行业进出口商品名称及HS编码
图表98：2017-2022年中国半导体材料进出口概况（单位：万吨，亿美元）
图表99：2017-2022年中国半导体材料进口情况（单位：万吨，亿美元）
图表100：2022年中国半导体材料进口产品结构-按金额（单位：%）
图表101：2022年中国半导体材料进口产品结构-按数量（单位：%）
图表102：2017-2022年中国半导体材料出口情况（单位：万吨，亿美元）
图表103：2022年中国半导体材料出口产品结构-按金额（单位：%）
图表104：2022年中国半导体材料出口产品结构-按数量（单位：%）
图表105：半导体材料行业现有企业的竞争分析表
图表106：半导体材料行业供应商议价能力分析表
图表107：半导体材料行业消费者议价能力分析表
图表108：半导体材料行业潜在进入者威胁分析表
图表109：中国半导体材料行业五力竞争综合分析
图表110：全球和中国半导体材料细分产品竞争格局（单位：%）
图表111：中国半导体材料对外依存度情况
图表112：截至2022年底中国晶圆制造材料国产化进程
图表113：中国半导体制造工艺及半导体材料的应用
图表114：2019-2022年中国半导体材料细分市场竞争格局（单位：%）
图表115：中国晶圆制造材料细分市场规模情况
图表116：中国半导体封装材料细分产品市场规模情况
图表117：区熔法
图表118：中国单晶硅片行业发展历程分析
图表119：截至2021年中国半导体硅片行业主要企业产能汇总（单位：万片/月）
图表120：2016-2022年中国半导体硅片市场规模（单位：亿美元）
略・・・・完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！